

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-002

### 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	招商证券、招商资管、海南千瓴私募基金、武当投资、英大证券、善道投资、华强集团、沅禾天润私募基金、高益私募证券基金、德馨资本、深圳蓝云世纪科技有限公司
时间	2025年5月27日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：冯学裕 董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p>1、近三年公司研发投入及占比呈下降趋势，请问未来在研发费用方面有何规划？下降的原因是什么？</p> <p>答：公司将技术创新定位为核心竞争力，公司长期结合成本效益分析对基础研究、核心技术的投入保持一定比例的投入，公司研发投入的增减主要基于公司业务发展需求。未来公司将根据市场反馈、技术进展及财务状况动态优化研发资源配置。</p> <p>2、半导体产品产能利用率偏低，且目前收入主要依赖智能卡业务，公司未来在半导体方面的布局规划是什么？</p> <p>答：半导体业务的具体产品主要包括载带、模块封装、专用芯片引线框架产品、TO功率半导体器件、SiC及IGBT等功率模块散热底座等封装材料。2019年宁波澄天芯片项目完成建设并投产，2022年开始逐步</p>

爬坡，2023 年度受半导体行业去库存影响短期承压，2024 年半导体及封装材料收入占比约 10%，2025 年公司半导体封装材料的产能利用率较高，2025 年一季度相关收入明显上涨。长期看，功率半导体器件及模块的封装材料需求将随新能源车、工业自动化等领域的增长而提升。

**3、半导体材料业务的毛利率水平如何？具体量级，主要客户群体是哪些？**

答：不同产品毛利率差异较大，参考可比上市公司，引线框架毛利率约 20%以内，散热铜底座等产品毛利率可达 20%-30%。公司已实现引线框架和散热铜底座的自主设计与量产落地，产品可覆盖 MOSFET、IGBT、SiC 及 IGBT 功率模块的封装需求。未来将积极向头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品，具体量级需结合客户订单节奏确定。随着下游新能源车、充电桩、工控设备等行业的快速发展，公司将进一步加大铜针式散热底板等高性能产品的推广力度，重点拓展头部功率模块客户及其工装配套企业。相关订单量级需根据客户项目导入节奏动态调整。整体来看，公司半导体材料业务具备持续提质增效空间，将为中长期毛利率水平的稳步提升提供支撑。

**4、介绍一下智慧安全业务**

答：公司依托于在数字信息安全领域多年行业沉淀，不断在智慧安全综合业务领域进行相关技术储备，公司的产品主要聚焦于交通安全领域，目前取得应用场景内的多个应用专利，产品规划应用于机场、车站、地铁等公共交通场所，智慧安全业务面向的整体市场空间广阔，且市场参与者数量有限，具备较高的行业准入门槛。公司在该领域已具备一定的技术优势，公司凭借第四代技术，在安全性、防夹伤等功能处于领先地位，今年来公司持续围绕该项目开展市场推广工作，后续业务发展中如涉及需披露的对外合作，公司将根据有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

**5、公司的超级 SIM 卡业务发展情况如何？**

答：公司凭借在智能卡领域的长期积累，紧跟行业技术发展的趋势，积极拓展超级 SIM 卡的应用范围，特别是在交通出行等高频使用场景中。与传统身份证检票方式相比，超级 SIM 卡在通行速度、便捷性和

系统集成能力方面展现出显著优势，能提供更优质的用户体验和更高的运行效率。在功能拓展、附加值提升等方面超级 SIM 卡优于传统智能卡，具备更广阔的市场发展潜力。目前公司与国内主要运营商建立了稳定深入的合作关系，持续推动超级 SIM 卡在更多垂直场景中的应用落地，以提升产品价值、延伸业务边界，并为后续规模化复制与推广打下坚实基础。

**6、公司液冷业务的技术优势及市场空间如何？预计何时实现规模化量产？**

答：公司液冷散热产品采用自研的高性能制造工艺，在结构一体化、导热效率与耐压性能方面具备明显性能优势。与传统工艺相比，具备更低的制造成本和更高的生超效率，可适应高功耗计算设备对散热性能的严苛要求。

目前，公司液冷产品已完成多轮技术验证，并通过部分服务器整机厂商的测试认证，具备良好的性能价格比。产品正处于量产准备阶段，将视客户需求和配套节奏推进商业落地。

从市场趋势看，随着 AI 服务器、高性能计算等领域对液冷散热需求快速增长，相关液冷模块的单体价值提升明显，整体市场空间可期。公司将持续围绕核心客户进行技术迭代与产品优化，力争在新一代散热解决方案中占据一席之地。

**7、公司在液冷业务方面与华为的合作情况如何？**

答：目前公司尚未与华为在液冷业务领域建立合作关系。若未来相关业务涉及与华为的合作，公司将严格遵循保密协议约定及客户合规要求，严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规要求履行信息披露义务。

**8、液冷板产品除应用于服务器外，还可用于哪些行业？是否已有产品产出？何时能批量化生产？和哪些客户合作？**

答：公司已建立起主流液冷产品所需的核心生产技术体系、配套设备能力及专业技术团队，具备从结构设计、材料匹配到工艺实施的全流程研发与制造能力。现有产品覆盖多种工艺路径，可满足不同应用场景下对热管理性能的差异化需求。

在服务器领域，公司液冷产品已完成多个阶段的技术验证，并具备进一步推广应用的基础。同时，公司也在积极拓展液冷技术在储能系统、新能源汽车热管理等领域的延伸应用，相关产品已进入部分客户测试和评估流程。

目前公司正与多家国内外客户就项目合作展开深入交流，具体合作进展受限于保密义务，暂不便披露。公司将根据实际市场需求及客户节奏，稳步推进液冷产品的多场景布局与产业化准备工作。

**9、液冷产品进入客户供应链后，在其中的地位如何？客户对成本和工艺的考量情况怎样？**

答：液冷产品在客户供应链中的导入通常伴随较高的技术门槛和验证要求，客户对系统性能、成本控制与工艺可靠性极为关注，尤其重视在保障使用稳定性和可靠性的同时实现整体热管理方案的优化。

公司当前产品在多个关键结构件中具备自主工艺优势，制造成本和热控效率表现良好，已获得部分客户在成本效益与技术成熟度方面的积极认可。公司已完成相关产权与产能储备，可支持后续批量交付。

同时，公司也在同步推进下一代液冷产品的预研工作，围绕更高热通量、更低能耗、更复杂结构的热管理需求，布局先进材料、复合结构设计及智能热控等方向，提升产品的技术前瞻性和客户粘性，为未来在多行业中的拓展奠定基础。

**10、液冷业务未来规划如何？是否有向芯片层面散热拓展的计划？**

答：公司液冷业务将围绕高热流密度场景，持续推进产品迭代与技术拓展，依托在热管理及半导体封装材料领域的积累，构建多层次应用场景、支持多工艺路径复合的热管理产品体系。

借鉴行业领先企业在散热赛道的技术演进路径，公司正积极布局更高集成度的散热解决方案，探索向芯片级热管理方向的技术延伸。未来将持续聚焦材料创新、结构与工艺协同，推动液冷产品在高性能计算、先进封装、新能源系统等关键领域的深度应用与战略落地。

**11、公司业务主要是自主规划还是通过收并购发展？未来对各业务的定位及战略规划是怎样的？**

答：截至目前公司以自主规划为主，暂无收并购方式。未来公司将持

	<p>续优化产品结构，以市场需求为导向，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在保持该业务市场份额的同时，围绕半导体封装材料、数字与能源热管理及智慧安全等技术储备拓展相关领域，为公司业绩提供新的增长点。</p> <p><b>12：公司新成立的澄天智算（上海）科技有限公司定位及业务规划是什么？是否有相关订单？</b></p> <p>答：该公司专注于人工智能计算能力领域，已成功取得国内某知名 GPU 制造商的 S 级代理权，并计划下半年启动销售活动。目前，公司已与潜在合作伙伴展开接洽，在业务拓展过程中，如涉及需披露的对外合作事宜，公司将根据有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。</p> <p><b>13、公司业务发展是否有需要资本储备？</b></p> <p>答：针对公司业务的发展，未来将根据业务拓展的需要进行审慎评估。如公司有扩产或其他重大融资活动，公司将及时依据法律法规要求进行信息披露。</p>
风险提示	<p>公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025-5-27